

ウエハ・製品信頼性～故障解析までワンストップで受託可能！！

トランジスタ評価	保有設備
HCI	<ul style="list-style-type: none"> Φ300対応セミオートプローバー -40℃～150℃、6～12inch 半導体パラメータアナライザー
NBTI	
TDDDB	
配線評価	保有設備
EM	400℃対応(100ヶ/チャンバー)
IMD-TDDDB	150℃対応
SM	恒温ベーク炉(制御可R.T.～400℃)

**ウエハ評価
& TEG評価
が受託可能**

AEC-Q100準拠信頼性試験	<p>AEC-Q100 & AEC-Q101 が受託可能</p>
INTEGRATED CIRCUITS (マイコン・SOC)	
AEC-Q101準拠信頼性	
DISCRETE SEMICONDUCTOR (パワーデバイス)	
AEC-Q101準拠信頼性	
DISCRETE OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR (LED)	

**AEC-Q100
&
AEC-Q101
が受託可能**



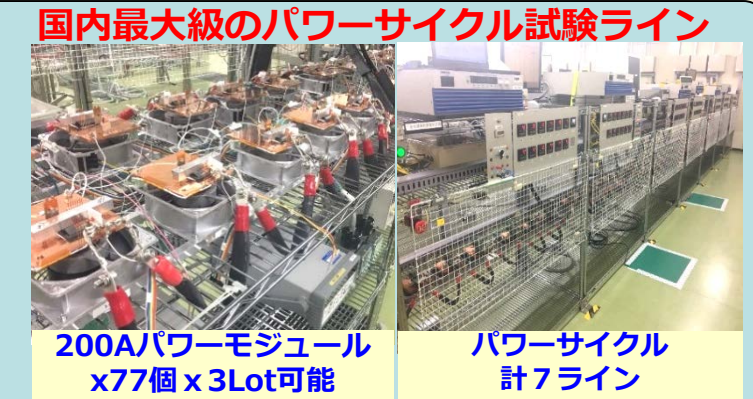
Φ300対応プローバー



EM評価装置



SOC 高温バインダ試験
x77個 x 3Lot対応可能



200Aパワーモジュール
x77個 x 3Lot可能

パワーサイクル
計7ライン

非破壊解析

電気的特性評価

外観検査

超音波映像観察 (SAT)

透過X線観察

半破壊解析

パッケージ開封

開封外観

故障解析

異常反応
疑似反応

光ビーム加熱抵抗
変動解析(OBIRCH)

発熱解析 (LIT)

(絞り込み)

プロービング解析

電流 Id (A)
電圧 Vg (V)

EOP/EOFM解析

物理解析

結晶欠陥

イオンリング

走査透過型電子
顕微鏡観察(STEM)

走査型電子
顕微鏡観察(SEM)

- ・エネルギー分散型X線分光分析 (EDS)
- ・電子エネルギー損失分光解析 (EELS)
- ・オージェ電子分光分析 (AES)
- ・集束イオンビーム加工観察 (FIB)
- ・透過型電子顕微鏡観察(TEM)
- ・パッケージ研磨
も受託可

マイコン、SoC、パワー、アナログ製品等の半導体の他、材料などの解析についても対応

解析サポート技術

- ・研磨 (各層除膜・裏面)
- ・回路修正 (28nmプロセス迄対応可)